

技術資料

EP-20-L04B

B-Stage 絕緣密封膠

簡介:

EP-20-L04B 適用於劃膠或鋼板印刷製程。主要用於壓合/封蓋、MEMS 封裝等。可用於黏著 LCP/PCB/玻璃/金屬/陶瓷等基材。常用應用於手機元件，傳感器等電子零件。

特徵:

- 適用於劃膠、印刷製程
- 不易吸濕
- 基板不易翹曲
- 二次烘烤溶劑型

硬化前特性		測試條件	測試方法
外觀	黑色	目視	FT-P006 FT-P025 FT-P024 FT-P018
黏度 @ 25°C	34000 cps	Brookfield DV-III/CP-51 @ 0.5rpm	
搖變指數@ 25°C	4.0	Visc @ 0.5rpm/Visc @ 5rpm	
細度	<20μm	細度計	
使用壽命 @ 25°C	72 小時	黏度升高 25%@ 5rpm(未暴露空氣中)	
保存期限 @-40 °C	6 個月		
硬化條件		測試條件	測試方法
建議固化條件(50um 膠厚)	乾燥段	60 分鐘@100°C(依實際膠體厚度增減)	
	固化段	60 分鐘@150°C 或 30 分鐘@175°C	
機械性質		測試條件	測試方法
推力 @ 25°C	>10 Kg	80*80min 晶片/Glass	FT-M012
推力 @ 25°C	>3 Kg	4.04*1.54mm LCP/PCB	
物理化學性質		測試條件	測試方法
玻璃轉移溫度(Tg)	82 °C	DMA 3 點彎曲模式	FT-P027

p.s.此表僅為 Feedpool 實驗室測試數據，投入生產前客戶仍需要針對產品做完整的驗證測試。

EP-20-L05B**絕緣密封膠**

物理化學性質	測試條件	測試方法
硬度 70	Durometer Shore D	FT-P037
熱膨脹係數 < Tg 52 ppm/°C > Tg 177 ppm/°C	TMA 膨脹模式	FT-M016
儲存模數 @25°C 2693 MPa @150°C 27 MPa @250°C 29 MPa	DMA 3 點彎曲模式試片厚度 <1.5 mm	FT-M019
熱裂解溫度 392°C	TGA 熱掃描	FT-P010

p.s.此表僅為 Feedpool 實驗室測試數據，投入生產前客戶仍需要針對產品做完整的驗證測試。

運用指導方針**運輸**

運送過程皆放入乾冰或低溫冰袋等低溫保存並放置溫度指示劑以確保產品品質。當您收到貨品時發現已無乾冰殘留（或溫度指示劑呈現液態），請立即拍照存證勿使用並立刻通知我司營業人員。

解凍處理

解凍時，請將針筒（瓶、罐）直立解凍，直到完全達室溫時才能使用(一般包裝回溫時間60分鐘)，請擦乾解凍時凝結在包裝外的水氣；不可反覆解凍及冷凍以防止異常分離現象及氣泡等之產生。

儲存條件

當您收到貨品時，請立即以低溫（-20°C或-40°C）儲存。由於不同溫度下之保存將影響產品的壽命（保存溫度與產品壽命成正比）